

2026 美國矽谷先進封裝與矽光子製造考察團

📍 2026 年 10 月 11 日-10 月 18 日 | 美國舊金山

- 🏷️ 指標看展：深入 SEMICON West 2026，掌握先進封裝 (PLP/3DIC) 與前沿半導體技術。
- 🚀 前瞻訪廠：直擊矽谷頂尖新創，深度對接次世代矽光子、先進封裝與 AI 智慧製造技術。
- 🤝 商務媒合：開拓北美半導體供應鏈，與在美傑出工程師組織及潛在買家深化交流。

本團以 SEMICON West 2026 國際會展為核心，聚焦先進封裝、異質整合與綠色永續製造之設備需求，協助會員企業掌握北美最新產業動態。行程除安排全日觀展與專業論壇對接外，亦精心規劃企業訪廠，**深入對接在矽光子與新型運算硬體領域極具代表性的矽谷新創公司**。期能藉由實地考察與技術座談，協助我國優秀設備與精密零組件廠商拓展北美市場，健全國際合作網絡。

日期	預定行程規劃	早	午	晚
10/12(一)	晚上 19:40 台北出發→舊金山(當日下午 16 點抵達)	✖	✖	√
10/13(二)	參觀『SEMICON WEST 2026』 聚焦 3DIC / PLP / 矽光子	√	X	√
10/14(三)	參觀『SEMICON WEST 2026』 高階技術論壇 (Keynotes & TechTalks)	√	X	√
10/15(四)	上午- 企業參訪 1 下午- 企業參訪 2	√	√	√
10/16(五)	企業參訪 3 21 點抵達機場報到，00:45 搭機返台	√	√	✖
10/17(六)-10/18(日)	抵達桃園機場 05:15	✖	X	X

1. 以上參訪公告係預定行程，主辦單位保留變更行程權利。
2. 上述報價為 15 人之團體費用，如人數未達將另行調整費用或無出團。

聯絡人：TEEIA Mavis 鄭晴文 | 02-27293933#35 | mavis@teeia.org.tw

2026 美國矽谷先進封裝與矽光子製造考察團

 限額招募 | TEEIA 會員限定 (未含機票費) 非會員另外加收台幣三萬元服務費

 報名期限 (7/30 日止)

 雙人房價 NTD 105,500 /人

單人房價 NTD 120,500 /人

▲ 由於當地交通與住宿價格浮動大，若幅度過大，公會每兩週根據浮動調整費用，敬請盡速報名，謝謝！

團費包含：

- 美國當地行程/交通/住宿與餐費
- 台灣旅客 ESTA 美國入境許可代辦費
- SEMICON WEST PASS
- 保險：團體旅遊責任險 500 萬及 20 萬意外醫療險。
- 小費：全程領隊、司機小費。

團費不包含項目：

- 護照/機票/個人旅遊及醫療保險
- 10/13 & 10/14 午餐費，及其他個人開支如旅館服務員小費等

其他細項說明：

- ◆ 上述報價為 15 人之團體費用，如人數未達將另行調整費用或無出團。為使本次交流參訪達最大效益，每家公司最多兩位參團名額，如有餘額再對外開放，不便之處，敬請見諒！
- ◆ 以上參訪公告係預定行程，主辦單位保留變更行程權利並事前公告所有報名者；如遇參訪場域或廠商有同業競業禁止，主辦單位有權變更行程或協調相關報名者變更行程。